

正 本

檔 號：

保存年限：

## 財團法人台灣經濟研究院 函

地址：104臺北市中山區德惠街16-8號7樓

承辦人：張郁菲

電話：02-25865000#323

傳真：02-25950988

電子信箱：d33605@tier.org.tw

受文者：台灣電子製造設備工業同業公會

發文日期：中華民國115年10月20日

發文字號：台經捌發字第1150006234號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送115年11月2日「全球供應鏈重組與臺美經貿合作」主題論壇會議資訊，敬邀貴單位報名與會，並惠請貴單位協助轉知會員廠商參閱及報名參加。

說明：

一、旨揭本論壇於2026年11月2日下午14:00~17:00假台北集思仁杭會議中心國際會議廳(台北市杭州南路1段24號3樓)舉辦。

二、報名網址：<https://tier.surveycake.biz/s/8RG6G>。即日起開放報名至額滿為止，敬邀貴單位派員與會，並請轉發給相關廠商、會員報名。

三、「全球供應鏈重組與臺美經貿合作」主題論壇資訊：

(一)會議時間：2026年11月2日14:00~17:00。(13:30開放報到入場。)

(二)會議形式：以全英文進行。

(三)詳見附件議程與說明。

四、如有疑問請洽本院周宇飛助理研究員(02-2586-5000分機322)。

正本：台灣電子製造設備工業同業公會

副本：

院長 張建一